|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | |  | **项目经理** | 黄海亮 | | |
| **项目代码** | |  | **软件版本号** | 1.0.2 | | |
| **测试方法** | | 黑盒测试 | **测试内容** | 焊接功能测试 | | |
| **用于测试的计算机软硬系统及其配置：**  CPU：Intel Dual-Core 2.0GHz，RAM：4GB，硬盘：64GB | | | | | | |
| **测试方案** | **序号** | **测试用例或测试内容** | **预期结果** | | **实测结果** | **备注** |
| 1 | 按照示教焊接电路板 | 流畅按照示教流程进行焊接 | | 错误 | 有时候出现z轴悬空焊接 |
| 2 | 机器回零 | 机器流畅回零 | | 错误 | 回零过程中出现突然卡顿 |
| 测试人员签字： 曾腾 2016年6 月8 日 | | | | | | |

软件测试记录表

文件编号：20160607-1

软件错误改正表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试文件号** | 20160607-1 | | **改正人员** | 黄海亮 | **测试人员** | 曾腾 |
| **序号** | **修改的错误** | **错误内容** | **修改的办法** | **再测试** | **备注** | |
| 1 | 按照示教焊接电路板 | 有时候出现z轴悬空焊接 | 硬件初始化参数超过极限值，重新设置为正常值后，悬空现象消失 | 正确 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |